

深圳清溢光电股份有限公司 关于高端半导体掩膜版研发进展的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）始终专注于掩膜版领域的技术创新与产品研发，致力于推动高端掩膜版产品的国产替代进程。近期，公司在半导体掩膜版领域取得重要进展，现将相关情况披露如下：

一、研发进展情况

截至本公告披露日，公司 55nm PSM（相移掩膜版）产品已与客户签署保密协议并确认产品规格书，已收到客户采购订单（PO），产品现已交货，进入客户上线认证阶段。PSM 相移掩膜版主要用于半导体芯片制造中对图形精度要求较高的关键光刻层，覆盖逻辑、存储、部分特色工艺及功率器件等高精密图形场景，可提升光刻分辨率、改善图形对比度，拓宽光刻工艺窗口，是公司半导体掩膜版业务向更高工艺节点突破的重要产品。

二、对公司的影响及风险提示

若 55nm PSM（相移掩膜版）产品顺利完成客户认证并实现规模化批量供货，将进一步完善公司高端半导体掩膜产品矩阵，提升公司半导体掩膜业务的整体盈利能力，优化产品结构，增强公司在国内半导体高端掩膜市场的核心竞争力。

上线认证属于客户验证的重要环节，认证周期、认证结果存在不确定性，尚不能确定何时能够实现批量供货。产品上线后的销售情况受下游半导体行业景气度、市场推广等因素影响，仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 29 日